

6-4-8 面取り幅不良／倒角的宽度不足 / Wrong chamfer angle

【特徴】 面取りスロープ幅が仕様を満たしていない状態の欠陥

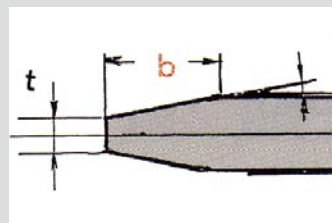
【特征】 倒角斜度不满足标准的缺陷。

【Characteristics】 Chamfer slope width does not meet the specification

【原因・判断ポイント・発生工程】 面取り加工作業者のセッティングミスや基板の板厚違いなどにより出来たもの（基板裁断工程、面取り加工工程）

【原因、判断要点、发生工序】 倒角加工操作人员的设定错误、或者板件的厚度等不同所造成的（板件裁切工序、倒角加工工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by an error of operator in setting board or selecting a wrong board thickness (Panel blanking and board chamfering process)



【コメント】
左図の b 寸法仕様を満たさない物
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
不满足左图的 b 尺寸标准
显微镜倍率 ×

【Comments】
b: out of specification
Magnification: ×



【コメント】
先端の面取りが殆ど無い状態
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
几乎没有前端的倒角
显微镜倍率 ×

【Comments】
Almost no chamfer at tip
Magnification: ×

6-4-9 ルータ加工不良／铣切加工不良 / Defective outlining

【特徴】 ルータ加工形状が違っている状態の欠陥

【特征】 铣切形状不相同的缺陷。

【Characteristics】 A routed shape is different from the shape specified.

【原因・判断ポイント・発生工程】 ルータ加工データの異常、あるいはワークの押さえ不足に起因するズレなどにより出来たもの（ルータ加工工程）

【原因、判断要点、发生工序】 铣切数据异常、或者板件的固定不牢导致偏移所引起的（铣切工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by erratical outlining data or shift of a work due to insufficient fixing (Routing process)



【コメント】
溝幅が部分的に広がっている
顕微鏡倍率 × 25

【注釋】
槽宽的局部变宽
显微镜倍率 × 25

【Comments】
Partially widened cut width
Magnification: ×25

【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×